

用途：放熱基板、等

1.概要と特徴

1-1)概要

独自のフィラー分散技術を用いた放熱特性に優れたボンディングフィルムです。ポリアミドとエポキシをポリマーアロイ化する事で、耐熱性と加工性を両立させております。

1-2)特徴

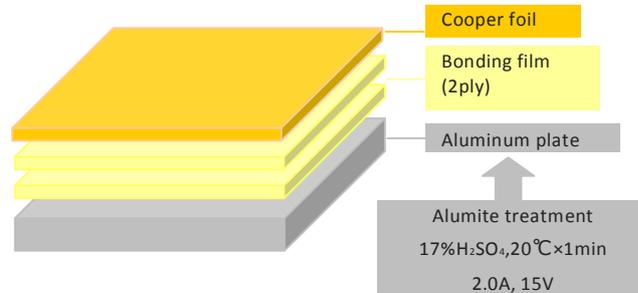
一般的な放熱材料と比較して、屈曲性があり、加工時のハンドリング性に優れます。また、200℃でのプレス成形が可能で、絶縁信頼性に優れる事が特徴です。



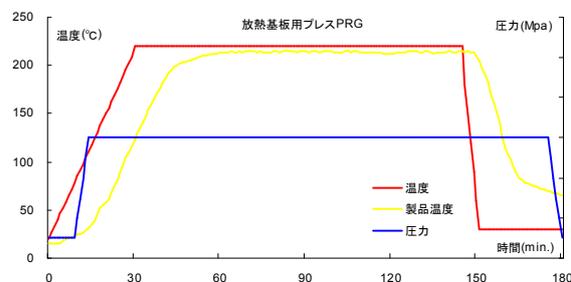
2.物性

| 項目 | 単位 | 特性値 | 備考 |
|-------------|-------|---------|------------------|
| 厚み | um | 50 | マイクロメーター(プレス成形後) |
| プレスフロー性(端辺) | mm | 3~5 | 当社推奨条件によるプレスフロー性 |
| ピール強度 | kN/m | 2.0~2.2 | 35um 電解銅箔 |
| はんだ耐熱性 | - | PASS | 300℃フロート |
| 絶縁破壊電圧 | kV | 5 | 50um×2ply,AC |
| 熱伝導率 | W/m・K | 3 | - |
| 熱分解温度 | ℃ | 450 | Td5 |

3.使用方法



キャビティ構造用にプレスフロー性を抑えたタイプもございます。お気軽にお問い合わせ下さいませ。



Press condition
200℃×60min/3Mpa

4.お問い合わせ先

〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-5
株式会社ピーアイ技術研究所 横浜本社 営業部
TEL：045-778-3355
FAX：045-778-3356
E-mail：info@pird.co.jp